

اینتل پردازنده‌های راکت لیک را با جعبه منحصر به فردی وارد بازار می‌کند - دیجیاتو

محمد قریشی | یکشنبه، ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

تصاویری از بسته‌بندی نسل یازدهم پردازنده‌های [اینتل](#) موسوم به «راکت لیک» منتشر شده‌اند که از طراحی متفاوت جعبه آن‌ها خبر می‌دهند. ظاهراً اینتل می‌خواهد با این جعبه، کاربران را برای پردازنده‌های راکت لیک هیجان‌زده کند.

پردازنده‌های راکت لیک ماه آینده میلادی از راه می‌رسند اما همچنان شاهد افشای اطلاعات جدیدی درباره آن‌ها هستیم که جدیدترین آن‌ها، مربوط به [نحوه بسته‌بندی](#) این پردازنده‌ها می‌شود. طبق تصاویر افشا شده، جعبه یکی از تراشه‌های سری اینتل Core i9 یعنی 11900K از طراحی متفاوتی بهره می‌برد.

این تصاویر جعبه‌ای با پلاستیک سخت را نشان می‌دهد که برای آن از چندین رنگ آبی استفاده شده و اطرافش شفاف است. این جعبه در حقیقت طراحی دوزنقه‌ای دارد که آن را جعبه سایر پردازنده‌های اینتل متمایز می‌کند.



با وجود چنین طراحی، نسخه‌های دیگر سری Core i9 با جعبه‌های استاندارد از راه می‌رسند. پردازنده‌های Core i9 با مدل 11900KF به همراه 11900F و 11900 جعبه معمولی خواهند داشت و خبری از طراحی متفاوت یا هیجان انگیز برای آن‌ها نیست.

پردازنده‌های راکت لیک مبتنی بر لیتوگرافی ۱۴ نانومتری هستند و از معماری جدید «Sunny Cove» بهره می‌برند. این معماری بهبود عملکرد نسل آینده پردازنده‌های اینتل را به همراه دارد و برای مثال شاهد دستیابی آن‌ها به حداکثر فرکانس ۵.۳ گیگاهرتز خواهیم بود.



با وجود چنین پیشرفت‌هایی، پردازنده‌های اینتل در مقایسه با AMD هسته‌های پردازشی کمتری خواهند داشت که همین موضوع می‌تواند برای آن دردسرساز شود. با این وجود، انتظار می‌رود پردازنده‌های جدید عملکرد قابل قبولی داشته باشند چرا که اینتل وضعیت مناسبی در بازار ندارد.

نه تنها شرکتی مانند AMD که رقیب سنتی اینتل محسوب می‌شود توانسته در سال‌های گذشته برای این کمپانی دردساز شود و سهمش را کاهش دهد، اپل هم با چیپ‌های مبتنی بر معماری ARM به دنبال حذف پردازنده‌های اینتل از کامپیوترهای مک است.

اینتل با [مدیرعامل جدیدش](#) می‌خواهد با چندین شرکت رقابت کند، بنابراین باید پردازنده‌های آینده‌اش عملکرد مناسبی داشته باشند. شاید طراحی منحصر به فرد بسته‌بندی پردازنده‌های راکت لیک هم نشان‌دهنده چنین موضوعی باشد.

[دیجیاتو](#)